

SMコンタクト
SM contact

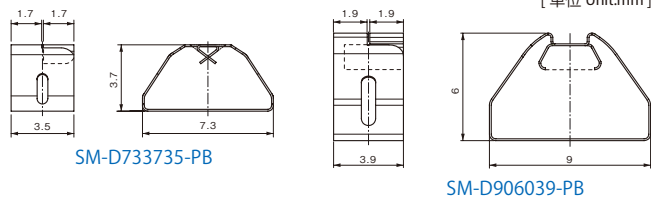
SM-D series



- 材質 / Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t = 0.1 mm)
- メッキ処理 / Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 / Recommended operating range SM-D733735-PB
高さ = 1.7 ~ 3.5mm Height: 1.7 mm to 3.5 mm
SM-D906039-PB
高さ = 3.5 ~ 5.8mm Height: 3.5 mm to 5.8 mm

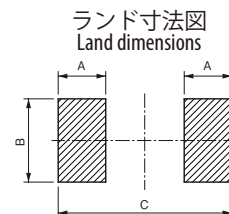
用途 Applications

■ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.



品番表 Product list

品番 Product code	寸法[mm] Dimensions [mm]			標準梱包数量 Standard packaging quantity	
	A	B	C	テーピング Taping	ダンボール Corrugated cardboard
SM-D733735-PB	2	3.5	7.3	2,500ヶ (リール) 2,500/reel	30,000ヶ (外箱) 12リール/1箱梱包 30,000/box (12 reels are packed in each box.)
SM-D906039-PB	2	3.9	9.0	1,800ヶ (リール) 1,800/reel	21,600ヶ (外箱) 12リール/1箱梱包 21,600/box (12 reels are packed in each box.)



特性 Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.01Ω以下 0.01 Ω or less	測定用基板上に半田付けし、製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	5N以下 (SM-D733735-PB) 5 N or less (SM-D733735-PB) 2.2N以下 (SM-D906039-PB) 2.2 N or less (SM-D906039-PB)	測定用基板上に半田付けし、製品を2.5mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。 測定用基板上に半田付けし、製品を4.2mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr
耐湿試験 Humidity test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: 60℃/95%RH 処理時間: 500hr
低温試験 Low temperature test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30% 以下 30% or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。処理温度: -40℃(3hr)~85℃(3hr) 処理時間: 12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3sec. (SM-D733735-PB)、5sec. (SM-D906039-PB)